

中国机电一体化技术应用协会

中机电协（2021）09号

关于征集 2021 首届中国大学生仿生设计大赛 承办单位的通知

各有关单位：

在生命、物质和信息等科学快速发展的今天，人类通过对自然界及生物的系统研究，寻找到了许多解决问题的新原理、新方法和新途径，为人类提供了最可靠、最灵活、最经济、最高效的生物技术系统，由此诞生了仿生学这一生物学和工程技术相结合的交叉学科。当前，仿生学已经成为新时期科学技术的前沿领域，在机械仿生、材料仿生、智能仿生、医疗仿生、军事仿生等领域得到了广泛应用与发展，也取得了令人瞩目的科技成果。

为有效发挥仿生学在我国原始科技创新中的作用，培养新时代仿生设计科技人才，国际仿生工程学会与中国机电一体化技术应用协会依据双方签订的战略合作协议，决定联合举办“2021 首届中国大学生仿生设计大赛”，现面向全国征集大赛承办单位，如有意向请于 2021 年 4 月 15 日前将承办申请表（见附件）通过电子邮件发送至联系人邮箱，同时将盖章签字的申请表一式两份邮寄至协会秘书处，我会对申办单位综合评估后予以公布结果。

联系人：李欣雨、王继宏

固定电话：010-62029218 、 82285782

移动电话：18210219521

电子邮箱：lixu@cameta.org.cn

地址：北京市西城区德胜门外大街教场口 1 号

邮编：100120

附件：承办单位申请表

中国机电一体化技术应用协会

2021年3月25日

